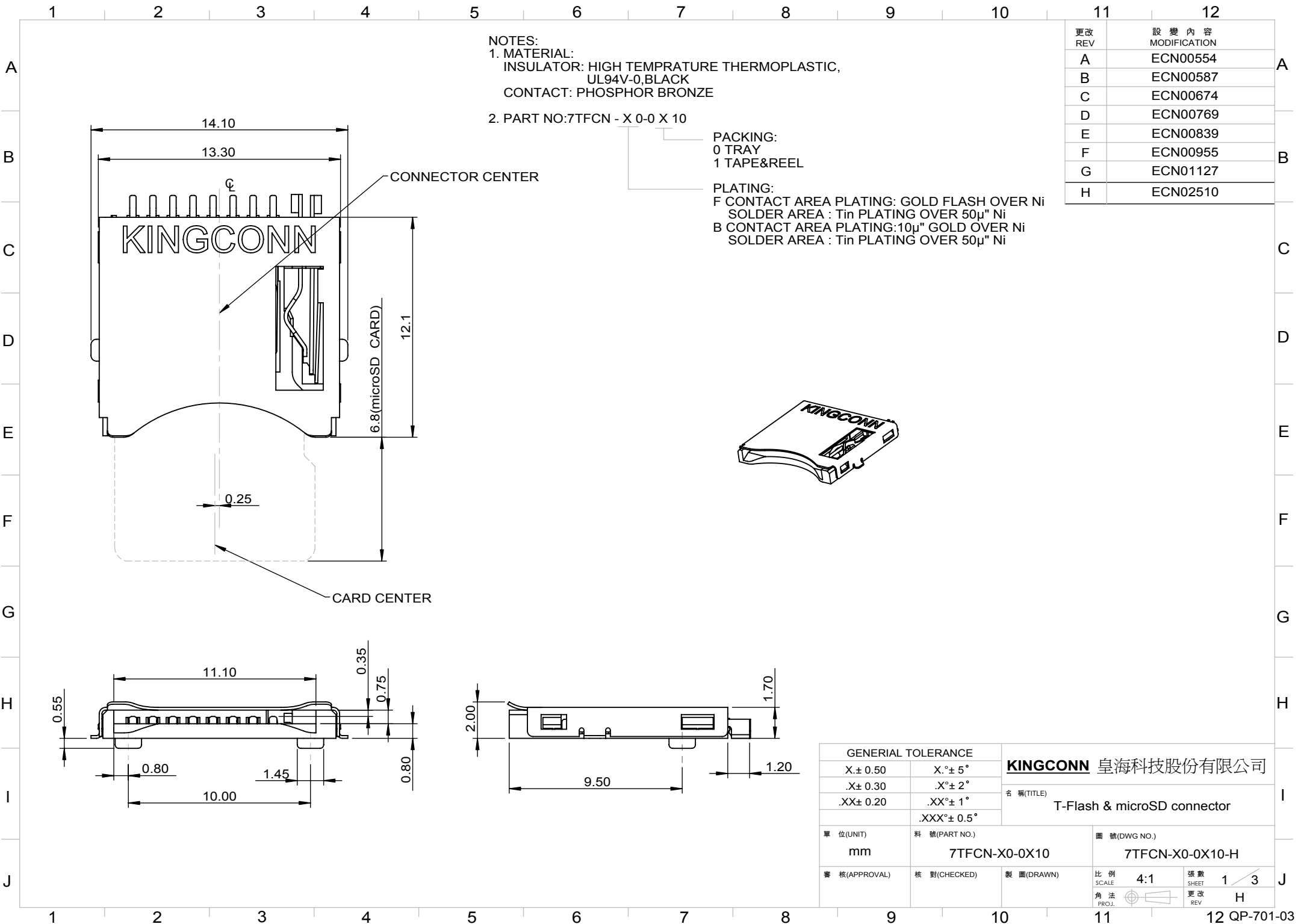




NOTES:
1. MATERIAL:
INSULATOR: HIGH TEMPRATURE THERMOPLASTIC,
UL94V-0,BLACK
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE

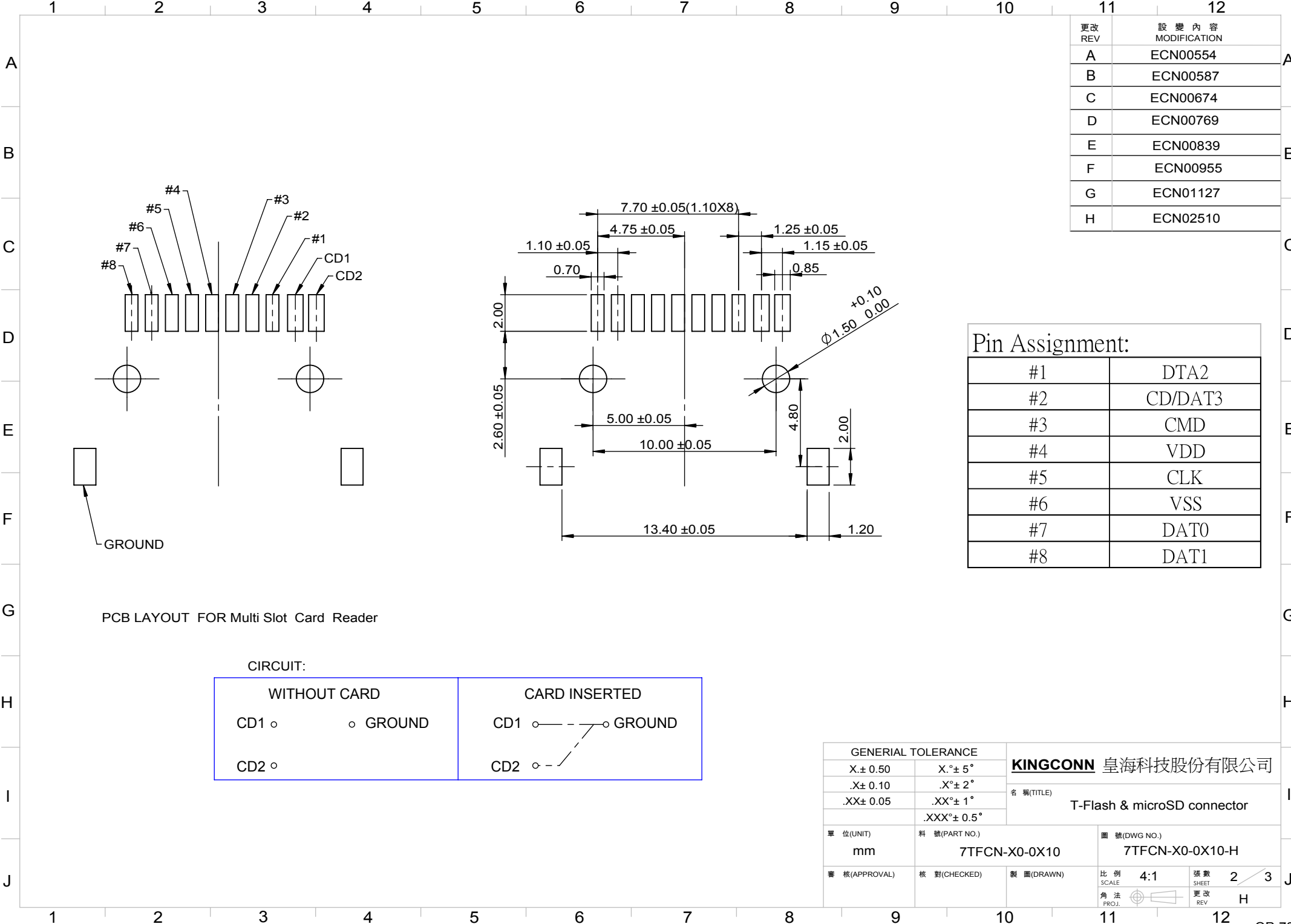
2. PART NO:7TFCN - X 0-0 X 10

PACKING:
0 TRAY
1 TAPE&REEL

PLATING:
F CONTACT AREA PLATING: GOLD FLASH OVER Ni
SOLDER AREA : Tin PLATING OVER 50μ" Ni
B CONTACT AREA PLATING:10μ" GOLD OVER Ni
SOLDER AREA : Tin PLATING OVER 50μ" Ni

更改 REV	設 變 內 容 MODIFICATION
A	ECN00554
B	ECN00587
C	ECN00674
D	ECN00769
E	ECN00839
F	ECN00955
G	ECN01127
H	ECN02510

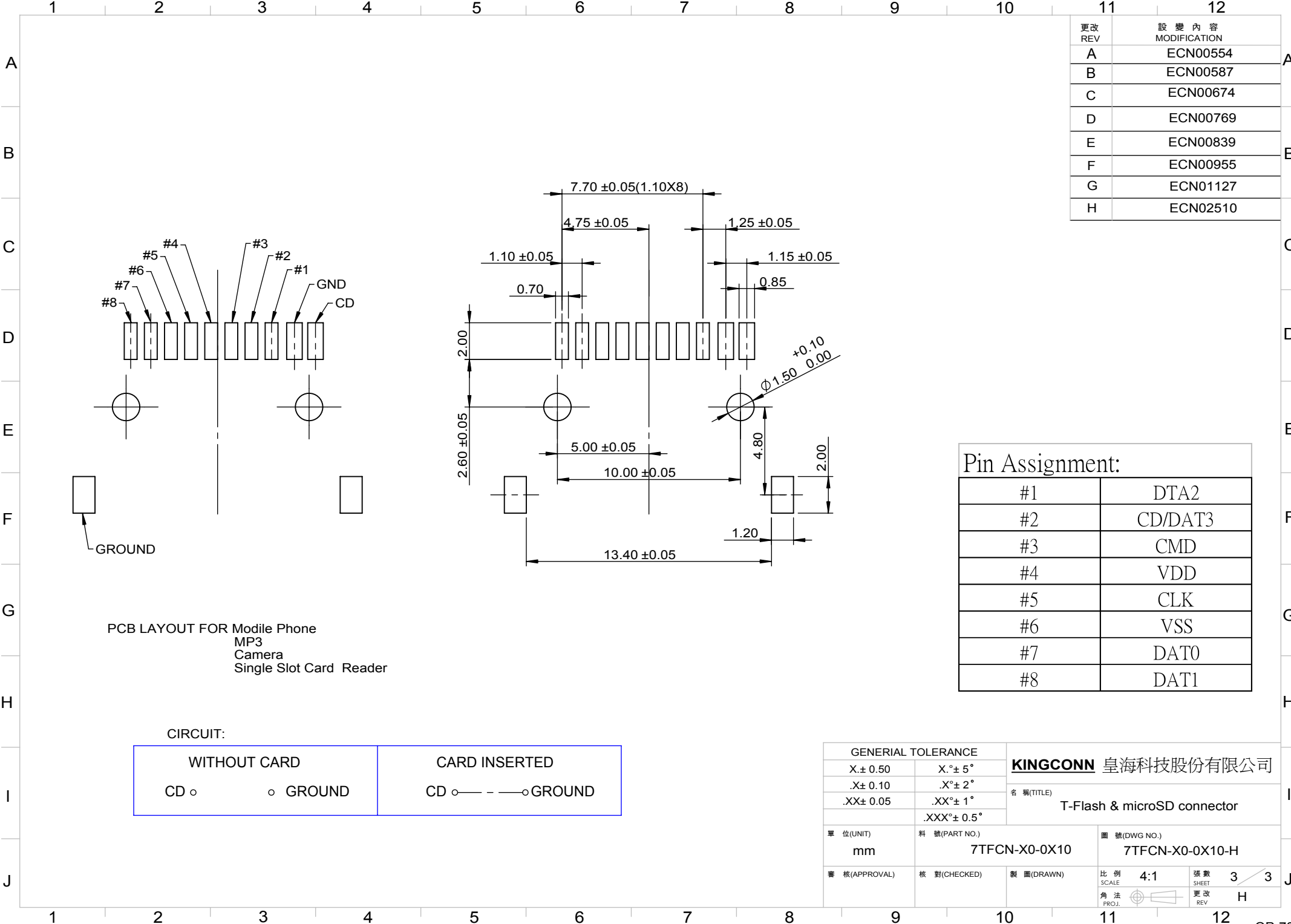
GENERAL TOLERANCE		名 稱(TITLE) KINGCONN 皇海科技股份有限公司 T-Flash & microSD connector	
X.± 0.50	X.°± 5°		
.X± 0.30	.X°± 2°		
.XX± 0.20	.XX°± 1°		
	.XXX°± 0.5°		
單 位(UNIT) mm	料 號(PART NO.) 7TFCN-X0-0X10	圖 號(DWG NO.) 7TFCN-X0-0X10-H	
審 核(APPROVAL)	核 對(CHECKED)	製 圖(DRAWN)	比 例 SCALE 4:1 角 法 PROJ.
			張 數 SHEET 1 / 3 更 改 REV H



更改 REV	設 變 內 容 MODIFICATION
A	ECN00554
B	ECN00587
C	ECN00674
D	ECN00769
E	ECN00839
F	ECN00955
G	ECN01127
H	ECN02510

Pin Assignment:	
#1	DTA2
#2	CD/DAT3
#3	CMD
#4	VDD
#5	CLK
#6	VSS
#7	DAT0
#8	DAT1

GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司 名 稱(TITLE) T-Flash & microSD connector	
X.± 0.50	X.°± 5°		
.X± 0.10	.X°± 2°		
.XX± 0.05	.XX°± 1°		
.XXX°± 0.5°		圖 號(DWG NO.) 7TFCN-X0-0X10-H	
單 位(UNIT) mm	料 號(PART NO.) 7TFCN-X0-0X10	比 例 SCALE 4:1	
審 核(APPROVAL)	核 對(CHECKED)	製 圖(DRAWN)	張 數 SHEET 2 / 3
		角 法 PROJ.	更 改 REV H



更改 REV	設 變 內 容 MODIFICATION
A	ECN00554
B	ECN00587
C	ECN00674
D	ECN00769
E	ECN00839
F	ECN00955
G	ECN01127
H	ECN02510

Pin Assignment:	
#1	DTA2
#2	CD/DAT3
#3	CMD
#4	VDD
#5	CLK
#6	VSS
#7	DAT0
#8	DAT1

CIRCUIT:	
WITHOUT CARD	CARD INSERTED
CD ○ ○ GROUND	CD ○ — — — ○ GROUND

GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司	
X ± 0.50	X ° ± 5 °		
.X ± 0.10	.X ° ± 2 °		
.XX ± 0.05	.XX ° ± 1 °		
	.XXX ° ± 0.5 °	名 稱(TITLE)	
		T-Flash & microSD connector	
單 位(UNIT)	料 號(PART NO.)	圖 號(DWG NO.)	
mm	7TFCN-X0-0X10	7TFCN-X0-0X10-H	
審 核(APPROVAL)	核 對(CHECKED)	製 圖(DRAWN)	比 例 SCALE 4:1
			張 數 SHEET 3 / 3
			角 法 PROJ. 更改 REV H